

**【1】. 適用範囲**

本指定書は、DM3BT シリーズの製品情報及びお取り扱い方法について規定するものです。

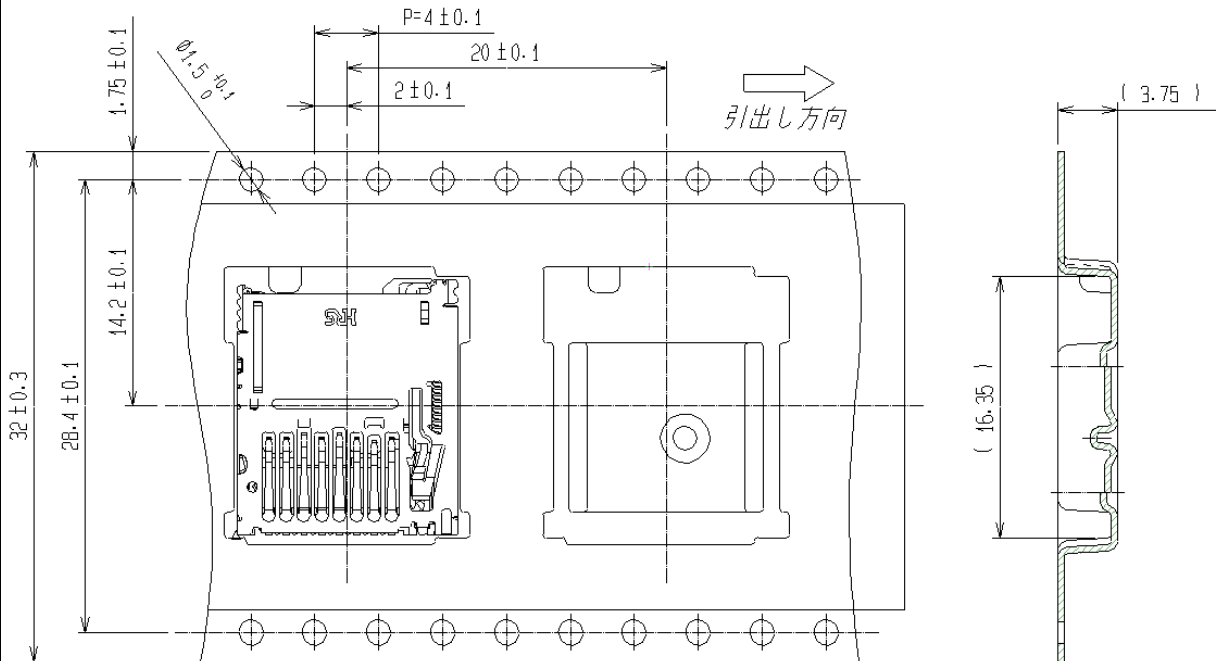
**【2】. 対象製品**

コネクタ品名	品 種
DM3BT-DSF-PEJ* (**)	microSD カード用コネクタ

**【3】. 製品情報**

◆梱包形態(JIS C 0806-3 準拠)

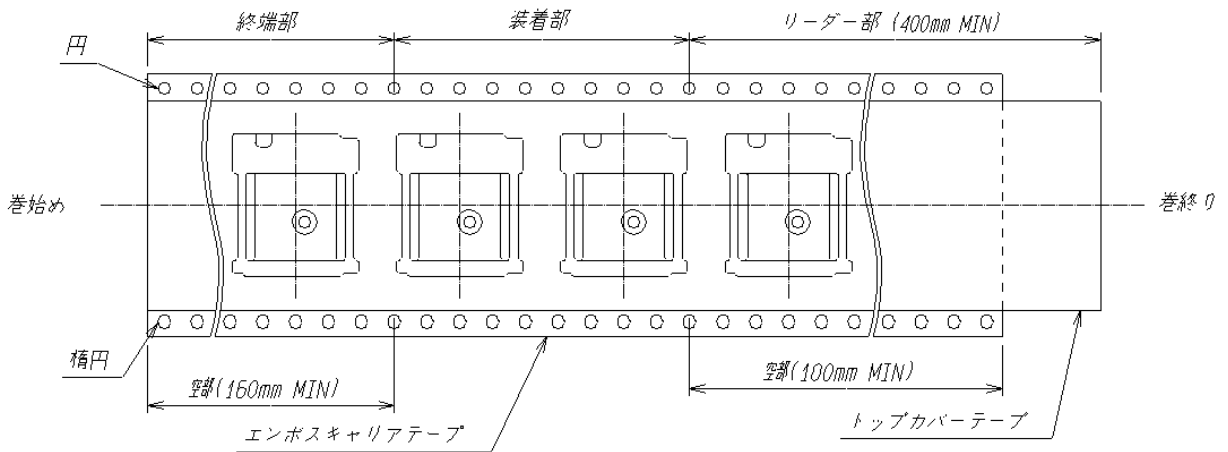
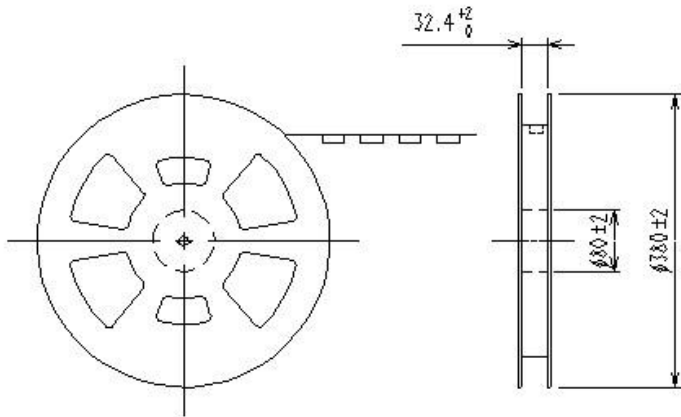
●エンボスキャリアテープ寸法図 1 リール : 1200 個巻き (※)



※仕様によっては、入り数及びポケットのピッチが異なる場合がございます。  
正式には納入仕様書を御確認頂きますようお願い申し上げます。

COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
△ 1	DIS-F-00021242	TY. EDAGAWA	HT. YAMAGUCHI	20240902
名称 TITLE		<b>HIROSE ELECTRIC CO., LTD.</b> APPROVED KI. AKIYAMA 20080826 CHECKED SI. TOMIOKA 20080826 DESIGNED KJ. NISHIWAKI 20080822 WRITTEN KJ. NISHIWAKI 20080822		
DM3BT シリーズ 各種製品情報及びお取扱いに関する説明書				
技術指定書 TECHICAL SPECIFICATION				
		ATAD-F0448		△ 1 / 10

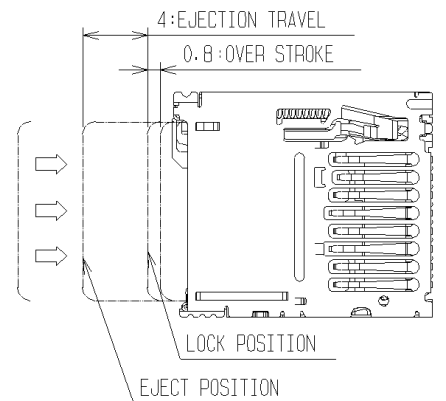
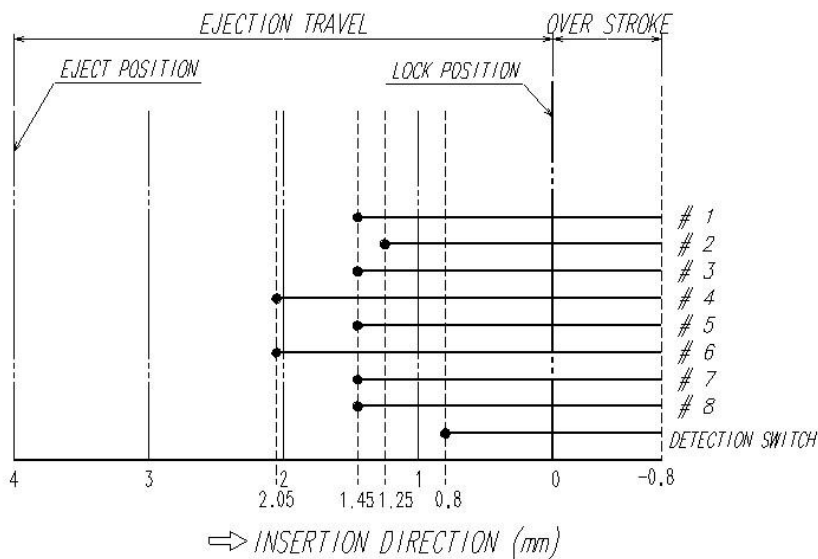
● リール状態寸法図




◆ 接触タイミング

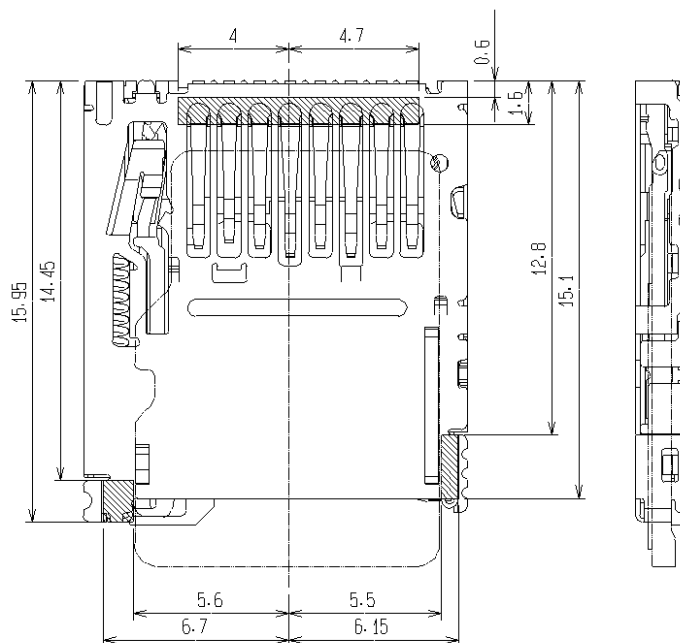
● 下図の接触タイミングチャートによる。

● CIRCUIT CLOSED




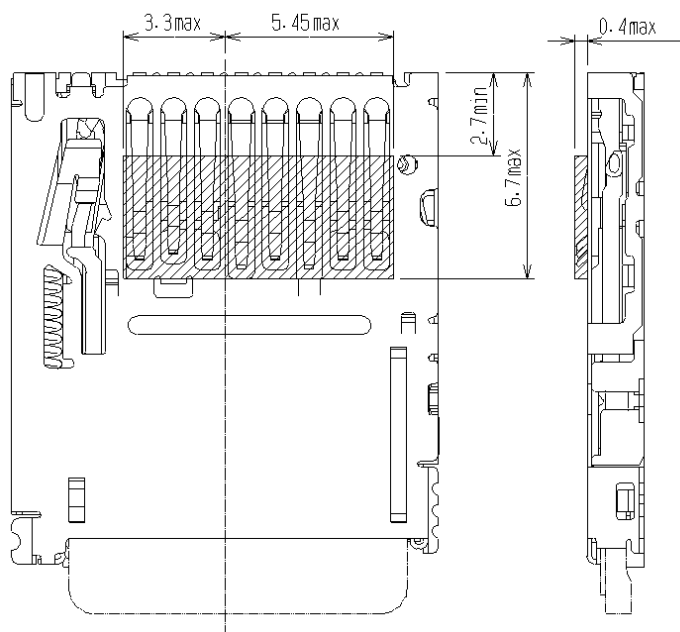
◆上面固定可能領域

●下図の  部は筐体により、製品上面からの固定が可能な領域を示します。



◆端子先端の外形出張り範囲

●下図の  部はカード挿入時に端子先端がコネクタ外形へ出張る範囲を示します。



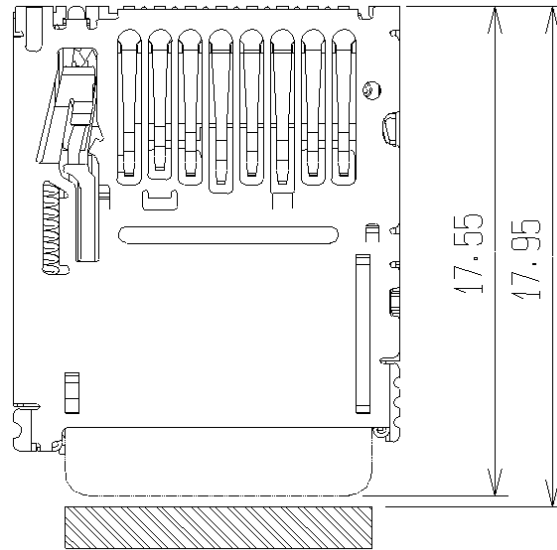
◆推奨筐体寸法

●推奨筐体寸法

カード挿入性向上のため、P. 7～9 に示します筐体寸法を推奨致します。

●カバー（蓋）取り付け推奨寸法

不慮の操作によるメディアの脱落、紛失等を避けるためカバー（蓋）のご使用をお願い致します。  
カバー（蓋）の取り付け位置は下図の寸法を推奨致します。



●カードの誤挿入防止マーク

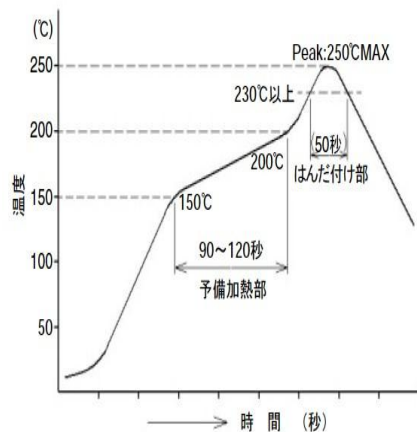
一般ユーザーがカードを誤挿入しないように、カード挿入方向を文字・カード挿入方向マーク等で注意喚起される場合は、文字・カード挿入方向マークの向きにご注意下さい。

◆FPC への実装について

●本製品は薄型をコンセプトとしております。FPC 基板へ実装される場合、補強板の板厚は0.3mm以上を推奨致します。

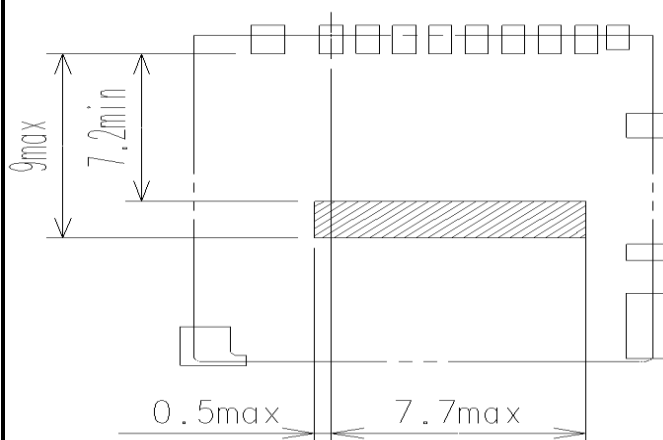
◆表面実装用接着剤の塗布推奨エリア

接着剤をご使用場合は下図の塗布可能エリア内でのご使用をお願いします。可能エリア外でのご使用は機能障害の原因となる恐れがございますのでご配慮下さい。  
また、多量に接着剤を塗布致しますと、製品の浮きによるはんだ未着の恐れがございます。接着剤は必要最低限の塗布量でお願いします。



推奨接着剤：SOMAKOTE IR-010H-3  
(ソマール株式会社製)

◆推奨温度プロファイル



<適用条件>

リフロー方式：遠赤・熱風併用リフロー  
リフロー雰囲気：大気  
使用はんだ：クリームタイプ Sn/3.0Ag/0.5Cu  
(千住金属製：M705-GRN360-K2-V)  
試験基板：ガラスエポキシ 60×100×1mm  
メタルマスク厚：0.12mm  
リフロー回数：2回以下  
メタルマスク開口率：推奨基板パターンにおいて100%。

この温度プロファイルは上記適用条件のものです。クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他の実装部材等の条件により異なる場合がございますので、実装状態を十分御確認の上ご使用願います。

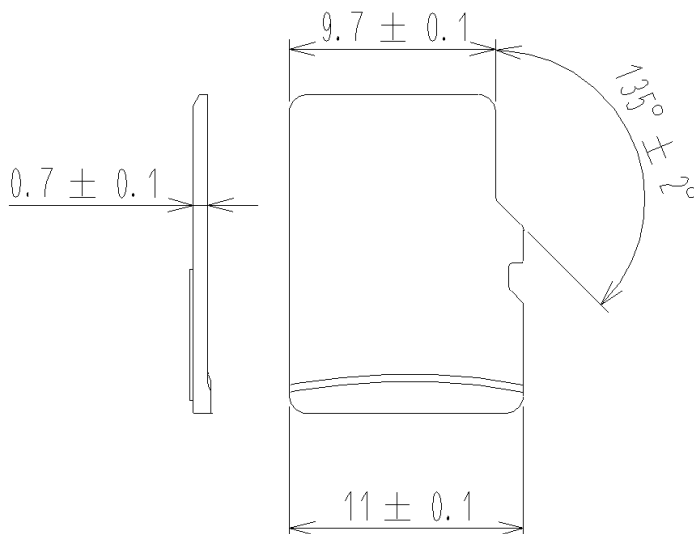
#### 【4】. 使用上のご注意

1. 本製品はイジェクト機構付き製品です。イジェクト機能不具合の原因になりますので、コネクタ全体の洗浄は行わないで下さい。洗浄を行う場合は、はんだ付け部のみを部分的に洗浄して下さい。  
また、洗浄剤がコネクタに残らないようにご注意願います。洗浄剤が残っている場合、カードの挿抜性および電気的性能の不具合原因になることがあります。



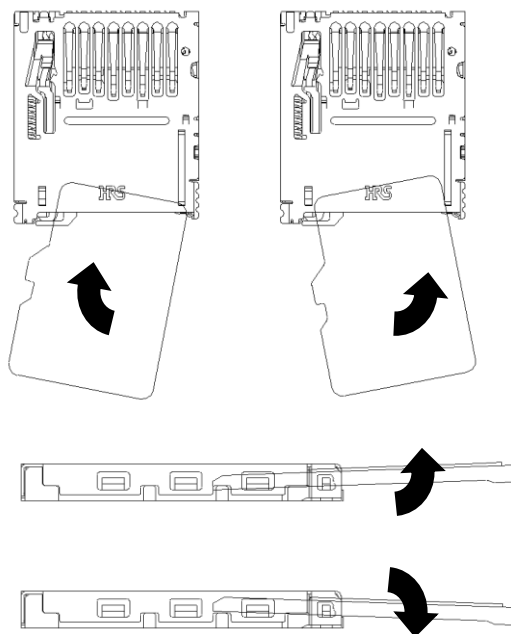
2. 本製品は摺動性向上のため潤滑剤を塗布しております。  
外観上潤滑剤が付着している場合がありますが、機能上問題ございません。  
カバーには、製造工程上プレスオイルの跡が残ることがございますが、ご使用上、機能上問題ございません。
3. お客様の組立工程内にて、カードの認識・動作検査を行われる場合、以下の項目にご注意頂き以下の項目を満足しない場合は、新しいカードに取り替えて検査を行って下さい。
  - ・コネクタに嵌合するカードは、下図の主要外形寸法が規格内のカードを用いてください。
  - ・特に磨耗による規格はずれにご注意ください。
  - ・パット部に極度の磨耗（素地の露出）が無いこと。

microSD カード規格主要外形寸法

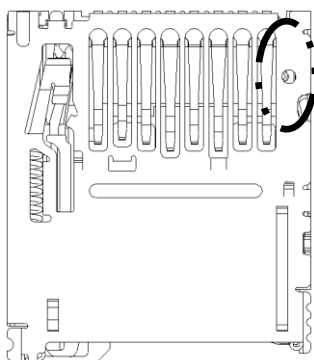


4. コネクタに過大な外力が加わりますと、障害や破損を引き起こす場合がありますので、コネクタの変形が無いよう、お取扱いには十分ご注意ください。  
特にお客様の組立工程内にて、筐体に取り付けない状態でカードの認識・動作検査を行われる場合、下図の様な動作は行わない様にご注意下さい。

- ・カードの上下左右方向の斜め挿抜
- ・カード仮挿入状態での上下左右方向のこじり挿抜



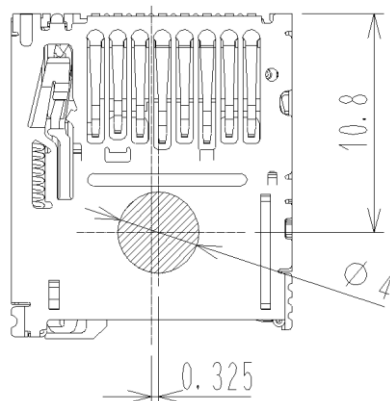
5. 本品は、低背をコンセプトにしたコネクタです。このため、検出端子部が外部に露出しています。お取扱いの際はご注意願います。



6. 本品は基板実装用コネクタです。  
単体での動作は、機能障害の生じる恐れがございますのでご遠慮下さい。
7. 本製品は microSD カード用のコネクタです。これらのカード以外のものは挿入しないで下さい。  
また、カードの逆挿入および斜め・こじり挿入はしないようにして下さい。  
本製品はカード逆挿入防止機構を有していますが、カード逆方向およびこじり方向などでカードを無理に挿入しますとカードおよびコネクタ破損の原因となることがあります。
8. カード嵌合状態からカードを無理に抜去しないで下さい。  
カードおよびコネクタ破損の原因となることがあります。
9. カードの材質上、表面に摺動痕が付きますが品質・製品性能上問題ありません。

10. カードのたわみ強度の規格は 10N となっております。カードへ過度の荷重を加えますとカード破損の原因となりますので、ご注意ください。

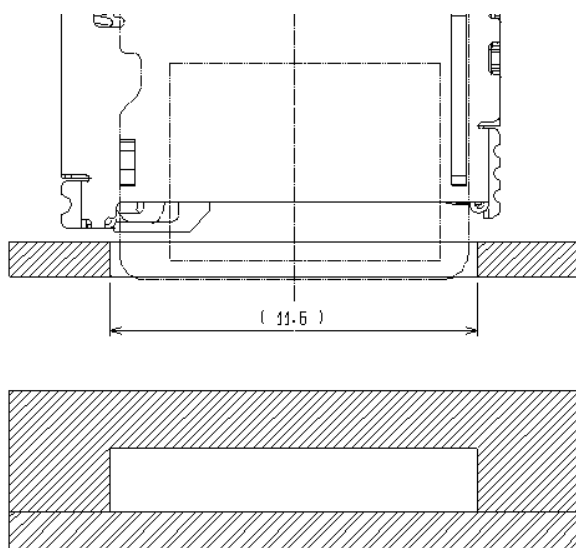
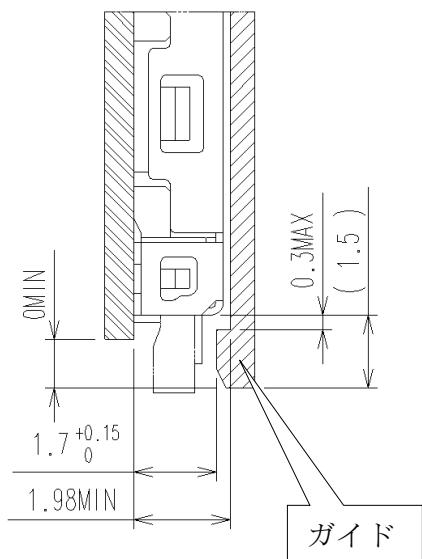
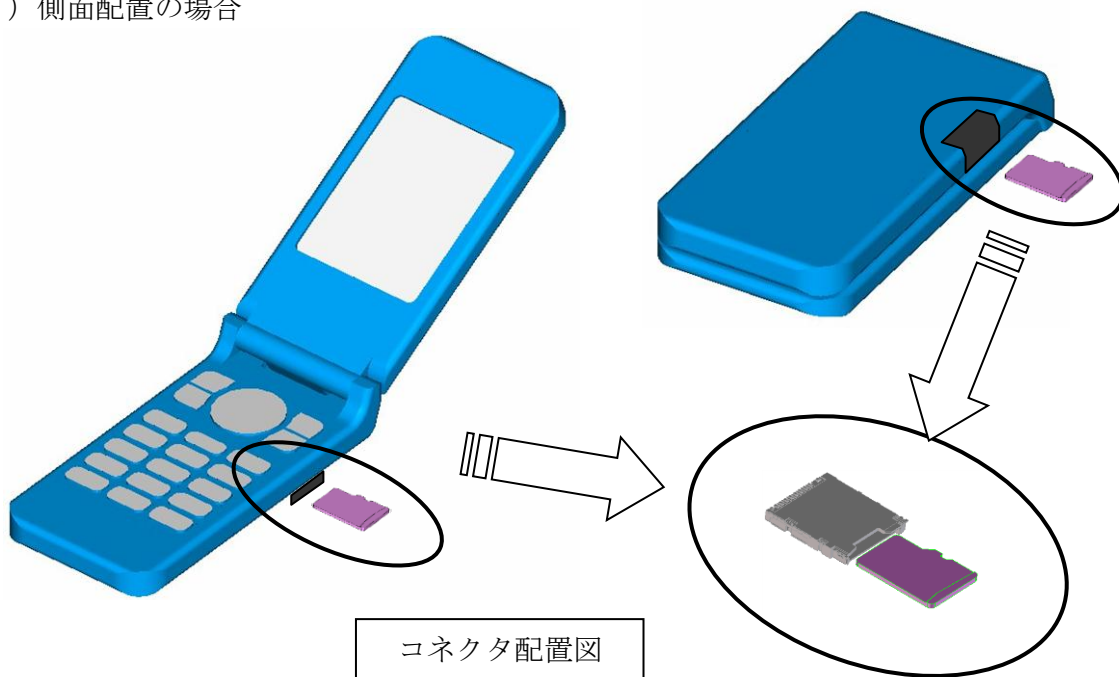
11. 下図は、本品の推奨吸着位置を示します。



#### ◆推奨筐体寸法

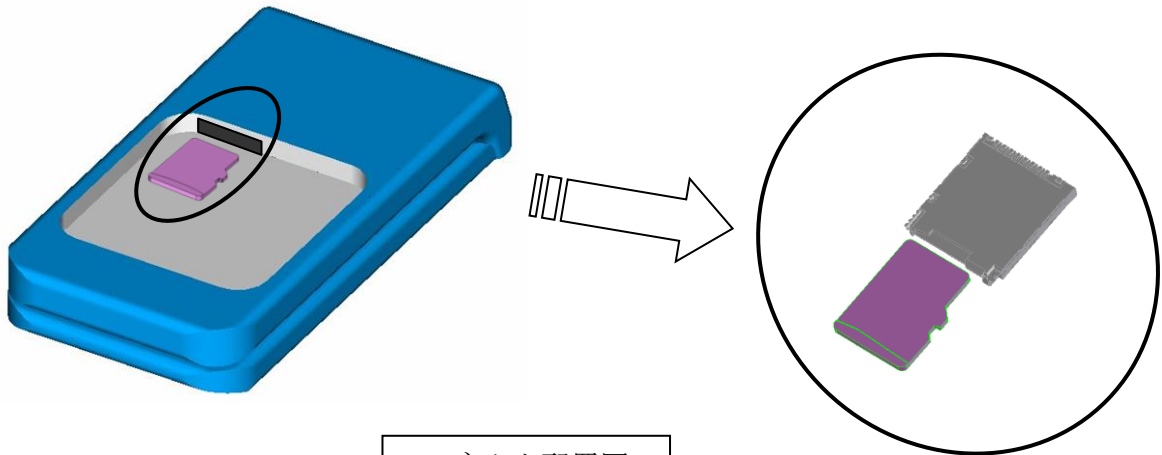
カード挿入性向上、こじり挿抜等によるコネクタの磨耗低減、及び破損回避のため、下図のような筐体設計により、イジェクター先端部を保護するためのガイドを設けることを推奨致します。

(I) 側面配置の場合

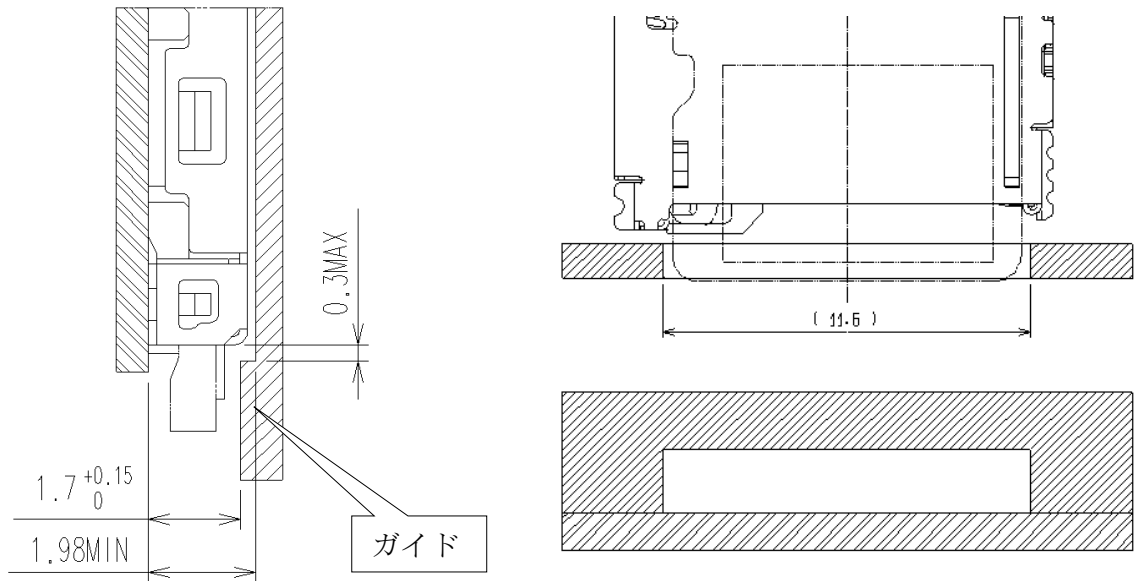




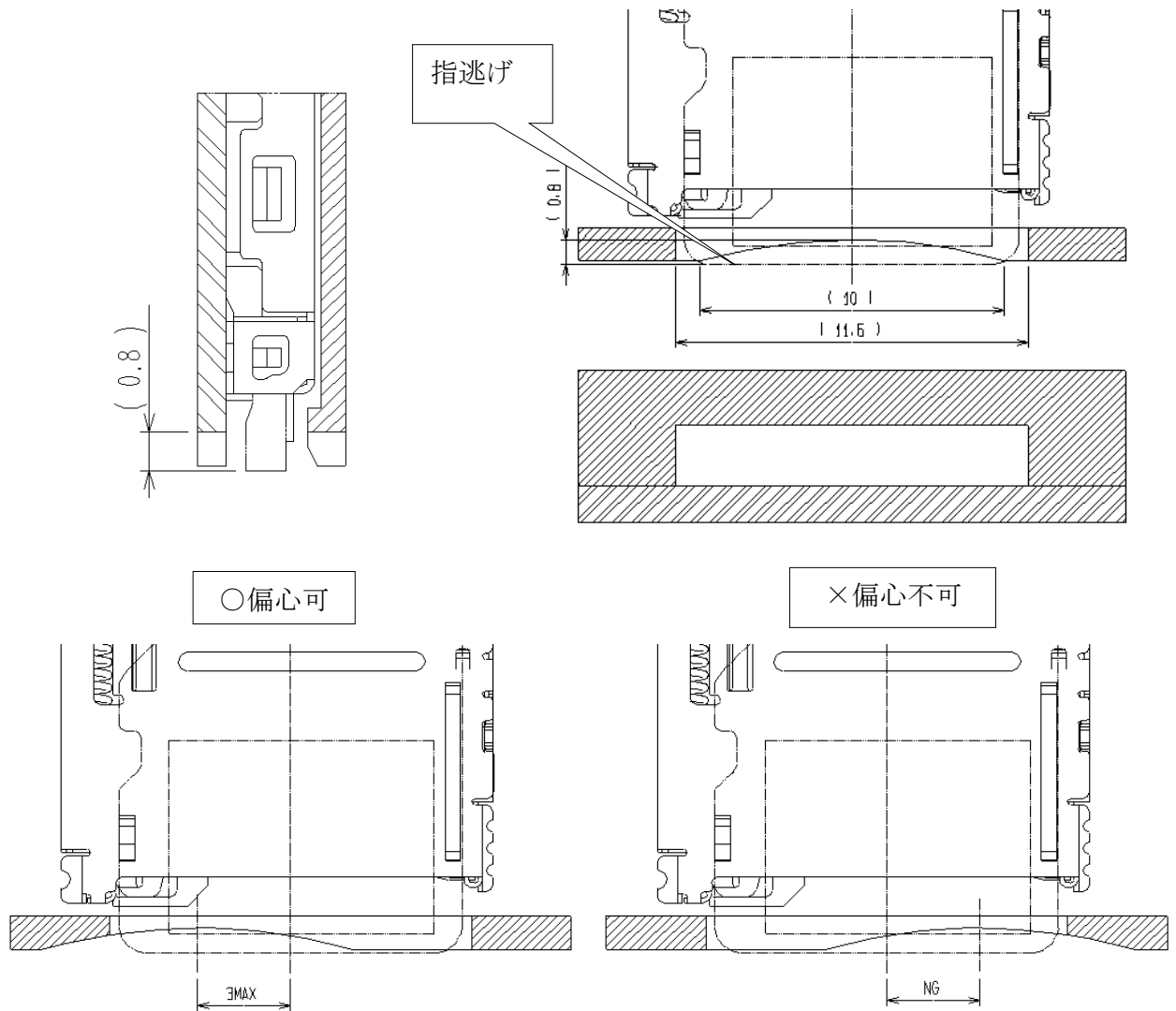
(II) バッテリー底面配置の場合



コネクタ配置図



カードの取り出しを容易にする為、筐体には下図のような「指逃げ」を設けることをお奨め致します。  
 また、斜め挿抜回避のため、指逃げの中心位置は、カード中心に対して図示の方向にのみ偏心可と致します。



なお、セットの設計上、全面にガイドが設けられない場合には、最低限下図に示す範囲にはガイドを設けることをお奨め致します。

